

【景美科技興櫃登錄 新聞稿】

## 景美科技 (7899) 將於 2026 年 2 月 25 日登錄興櫃 AI 先進製程測試需求強勁 帶動營運與獲利連年躍升

2026 年 2 月 23 日台北市

半導體先進製程測試介面 關鍵結構件供應商 景美科技股份有限公司 ( 股票代號：7899 ) 將於 2026 年 2 月 25 日正式登錄興櫃交易。公司成立於 2006 年，實收資本額約新台幣 2.29 億元，深耕探針卡關鍵結構件、細微鑽孔製程近二十年，長期服務一線晶圓代工與全球探針卡大廠，具備研發、製造與規模量產整合能力。產品主要應用於垂直式探針卡 (Cobra) 與微機電探針卡 (MEMS)，核心產品涵蓋上下導板細微鑽孔 (Upper Plate / Lower Plate)、ATE Stiffener、Spacer、JIG、Backer 等高精度、高門檻關鍵結構件，為高階晶片測試不可或缺的重要組成。

- **在營運表現方面**，景美科技近三年呈現明顯成長與體質改善趨勢。2023 年營收約新台幣 2.16 億元，受疫後產業景氣循環影響，當年度呈現虧損。2024 年隨 AI 晶片測試需求放量、先進封裝測試訂單增加，全年營收成長至約 3.67 億元，毛利率提升至約 35%，成功轉虧為盈，每股盈餘約 1.8 元。2025 年在細微鑽孔件與先進製程結構件強勁需求帶動下，自結營收約 4.3 億元，毛利率進一步提升至 40%，獲利維持穩定水準，顯示公司已進入規模放大與產品組合優化的成長階段。另外營收高度集中於先進製程，應用在先進製程產品占比高達 78%。
- **在產業趨勢方面**，景美科技總經理羅麗文表示，隨著 AI 與 HPC 晶片快速發展，訊號接點密度與測試針數持續提升，帶動單張探針卡對導板孔數與結構精度的需求同步升級。由於細微鑽孔多以孔數計價，針數越高、孔位越密集，對應加工價值亦隨之提高，形成具延續性的結構性成長動能。依據 TechInsights 與 Yole 等產業研究機構預估，全球探針卡市場規模至 2029 年可望成長至近 40 億美元，為高階測試介面供應鏈提供長期需求支撐。

此外，產業分工趨勢亦有利公司定位。探針卡大廠近年將資本優先投入 探針針體、PCB、多層有機載板與關鍵核心製程設備，並將結構件與精密加工環節委由專業供應商承接，形成長期且穩定的分工體系。在「專業分工、協同擴產」的群體作戰模式下，景美科技正位於關鍵製造節點，成為多家國際探針卡大廠的重要製造延伸與技術後盾。同時，公司已逐步切入高階 Final Test 測試介面結構件應用，產品線由前段晶圓測試延伸至後段高階測試，擴大可服務市場範圍。

- **在競爭利基方面**，景美科技建立三大核心優勢。
  1. 陶瓷導板細微鑽孔屬高難度加工製程，材料硬脆、孔徑與孔距公差要求極嚴，需長期製程參數累積與量產經驗，新進者進入門檻高。
  2. 公司同時具備細微機械鑽孔、雷射鑽孔與精密 CNC 結構件整合能力，可提供整套結構件解決方案，而非單點加工服務，客戶黏著度高。
  3. 具備多家國際一線客戶認證，品質穩定與交期可靠建立合作基礎。同時透過「研發驅動量產、量產回饋研發」的正向循環機制，優化製程與產品設計，形成可規模化複製的研發與量產整合能力，建立不易複製的技術門檻與供應鏈護城河。
  
- **展望未來**，景美科技將持續聚焦高精度製程能力升級與高毛利產品比重，並配合客戶需求推進產能擴充與自動化投資。在 AI、先進封裝與高階測試需求長期成長趨勢帶動下，公司可望持續受惠於高針數、高複雜度測試介面升級循環。此次登錄興櫃，除提升資本市場能見度與公司治理透明度外，也將為後續技術深化與產能布局提供更穩固基礎，朝向全球先進製程測試介面關鍵供應商目標穩健邁進。

**景美科技 營收獲利比較表**

單位：新台幣仟元；%

|            | 2023 年度 | 2024 年度 | 2025 年度<br>(自結) | 2024 & 2025<br>年度增減% |
|------------|---------|---------|-----------------|----------------------|
| 營業收入       | 216,126 | 367,437 | 430,256         | 17%                  |
| 營業毛利       | 45,902  | 128,902 | 173,206         | 34%                  |
| 營業毛利率      | 21%     | 35%     | 40%             | -                    |
| 營業利益       | -21,564 | 44,266  | 67,173          | 52%                  |
| 營業利益率      | -10%    | 12%     | 16%             | -                    |
| 淨利率        | -17%    | 9%      | 8%              | -                    |
| 稅後淨利       | -36,008 | 33,344  | 36,124          | 8%                   |
| 每股稅後盈(元)   | -1.94   | 1.80    | 1.67            | -                    |
| 加權平均股數(仟股) | 18,515  | 18,515  | 21,590          |                      |

全球信賴的半導體測試介面核心專家  
(先進製程的細微鑽孔 / 探針卡結構件設計製造)



圖說： 景美科技 陳吉良董事長(左) 羅麗文總經理(右)

產品說明:

先進製程探針卡用測試機框(展示桌上)：

先進製程細微鑽孔件(手上產品)